

嘉兴斯达半导体股份有限公司

关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

1、2020 年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉兴斯达半导体股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2019] 2922 号)核准，由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）4,000.00 万股，发行价格为每股 12.74 元。

公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000.00 万股，募集资金总额人民币 50,960.00 万元，扣除承销费和保荐费人民币 3,500.00 万元（含税价）后的募集资金为人民币 47,460.00 万元，已于 2020 年 01 月 21 日全部到账。本次募集资金总额人民币 50,960.00 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 5,010.67 万元后，实际募集资金净额人民币 45,949.33 万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2020]第 ZA10026 号验资报告。

2、2021 年非公开发行股票

2021 年 09 月，中国证券监督管理委员会《关于核准嘉兴斯达半导体股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021] 3201 号)核准公司非公开发行不

超过 1,600 万股新股。

公司实际向 J.P. Morgan Chase Bank、National Association、富国基金管理有限公司、BARCLAYS BANK PLC 等 14 位认购人合计发行人民币普通股股票 10,606,060 股，每股面值 1.00 元，发行价格 330.00 元/股，共计募集资金人民币 349,999.98 万元，扣除承销费人民币 2,200.00 万元（含税价）后的募集资金为人民币 347,799.98 万元，已于 2021 年 11 月 03 日全部到账。本次募集资金总额人民币 349,999.98 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 2,304.93 万元后，实际募集资金净额人民币 347,695.05 万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2021]第 ZA15756 号验资报告。

（二） 募集资金使用情况及结余情况

1、2020 年首次公开发行股票

单位：人民币元

项目		金额
募集资金总额		509,600,000.00
减：发行费用		50,106,694.50
募集资金净额		459,493,305.50
截止期初	项目累计投入	404,509,800.43
	募集资金用于现金管理取得的理财收益	4,234,558.09
累计发生额	利息收入扣除手续费净额	1,487,917.50
	项目累计投入	10,000,906.76
本期发生额	募集资金用于现金管理取得的理财收益	
	利息收入扣除手续费净额	5,413.18
	尚未到期的理财产品	
	闲置募集资金暂时补充流动资金	50,244,020.97
截至 2022 年 06 月 30 日募集资金期末余额		466,466.11

2、2021 年非公开发行股票

单位：人民币元

项目		金额
募集资金总额		3,499,999,800.00
减：发行费用（注 1）		23,049,272.04
募集资金净额		3,476,950,527.96

截止期初 累计发生额	项目累计投入	959,720,747.44
	募集资金用于现金管理取得的理财收益	1,564,643.83
	利息收入扣除手续费净额	4,436,969.92
本期发生额	项目累计投入	152,954,654.67
	募集资金用于现金管理取得的理财收益	2,560,273.97
	利息收入扣除手续费净额	46,405,645.07
	尚未到期的理财产品	1,600,000,000.00
	闲置募集资金暂时补充流动资金	
截至 2022 年 06 月 30 日募集资金期末余额		819,242,658.64

注 1：本期尚未支付发行费用 754,716.98 元。

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《嘉兴斯达半导体股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。

1、2020年首次公开发行股票

2020年01月23日，公司会同保荐机构中信证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司嘉兴分行营业部、杭州银行股份有限公司嘉兴分行、中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020年06月29日，子公司上海道之科技有限公司（以下简称上海道之）与公司作为募投项目新能源汽车用IGBT模块扩产项目实施主体，会同保荐机构中信证券股份有限公司与杭州银行股份有限公司嘉兴分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，本公司在募集资金的使用过程中均按监管协议的规定履行，不存在重大问题。

2、2021年非公开发行股票

2021年11月15日，公司会同保荐机构中信证券股份有限公司分别与杭州银行股份有限公司嘉兴分行、中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2021年11月26日，嘉兴斯达微电子有限公司（以下简称斯达微电子）与公司会同保荐机构中信证券股份有限公司与杭州银行股份有限公司嘉兴分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，本公司在募集资金的使用过程中均按监管协议的规定履行，不存在重大问题。

(二) 募集资金专户存储情况

1、2020 年首次公开发行股票

截至2022年06月30日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行名称	银行账号	存储方式	期末余额
嘉兴斯达半导体股份有限公司	交通银行股份有限公司嘉兴分行营业部	334899991013000045994	活期	3,426.67
嘉兴斯达半导体股份有限公司	中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行	19310101040021256	活期	455,807.12
嘉兴斯达半导体股份有限公司	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	3304040160000575875	活期	5,373.65
上海道之科技有限公司	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	3304040160000630548	活期	1,858.67

2、2021 年非公开发行股票

截至2022年06月30日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行名称	银行账号	存储方式	期末余额
嘉兴斯达半导体股份有限公司	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	3304040160000746187	活期	567,451,876.49
嘉兴斯达半导体股份有限公司	中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行	19310101040024557	活期	1,015,777.84
嘉兴斯达半导体股份有限公司	中国民生银行嘉兴分行	633749183	活期	2,280,285.95
嘉兴斯达微电子股份有限公司	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	3304040160000749264	活期	249,249,435.34

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1、2020 年首次公开发行股票

2022 年 1-6 月，本公司实际使用 2020 年首次公开发行股票募集资金人民币 10,000,906.76 元，具体情况详见附表 1《2020 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、2021 年非公开发行股票

2022 年 1-6 月，本公司实际使用 2021 年非公开发行股票募集资金人民币 152,954,654.67 元，具体情况详见附表 2《2021 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

1、2020 年首次公开发行股票

截止 2020 年 06 月 16 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 6,148.06 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核，并出具了《专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZA15013 号）。

上述代垫投入的自筹资金，经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，独立董事、公司监事会、发表明确同意意见，保荐机构出具了核查意见。信息披露情况请见公司于 2020 年 06 月 24 日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-035）。

2、2021 年非公开发行股票

截止 2021 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的实际投资金额为人民币 16,088.32 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核，并出具了《专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZA10711 号）。

上述代垫投入的自筹资金，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，独立董事、公司监事会、发表明确同意意见，保荐机构出具了核查意见。信息披露情况请见公司于 2022 年 04 月 08 日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-013）。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2020 年首次公开发行股票

公司于 2020 年 06 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过 10,000.00 万元暂时闲置募集资金用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了核查意见。截至 2021 年 06 月 21 日，公司实际使用募集资金暂时补充流动资金总额为 10,000 万元，并已全部归还至募集资金专用账户。

公司于 2021 年 07 月 06 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过 8,000.00 万元暂时闲置募集资金用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了核查意见。

截止 2022 年 06 月 30 日，公司实际使用闲置募集资金补充流动资金金额为 5,024.40 万元。

2、2021 年非公开发行股票

本公司 2021 年非公开发行股票募集资金不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2020 年 04 月 28 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意为了提高资金使用效率，增加现金资产收益，授权公司管理层使用额度不超过人民币 50,000.00 万元暂时闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品。期限为股东大会审议批准之日起至下次有权授权机构批准作出新的决议前有效。上述额度在决议有效期内，可以滚动使用。

公司于 2021 年 12 月 03 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关

于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意为了提高资金使用效率，增加现金资产收益，授权公司管理层使用额度不超过人民币 250,000.00 万元的暂时闲置资金和不超过 250,000.00 万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品。期限为自公司股东大会审议通过之日起至股东大会（或公司有权机构）审议批准下一年度募集资金进行现金管理有关授权之日止，投资额度在上述投资期限内可滚动使用。

1、2021 年非公开发行股票

单位：人民币万元

签约方	签约银行	产品名称	实际使用金额	起始日期	终止日期	收益金额	期末投资份额	是否如期归还
嘉兴斯达半导体股份有限公司	中国民生银行嘉兴分行	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款 (SDGA220285Z)	160,000.00	2022 年 06 月 02 日	2022 年 09 月 02 日		160,000.00	

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

1、2020 年首次公开发行股票

公司于 2020 年 11 月 30 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目并等额从募集资金专户划转至公司一般账户。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了核查意见。

本期公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目并等额从募集资金专户

划转至公司一般账户的金额为 0 元。

2、2021 年非公开发行股票

本公司 2021 年非公开发行股票募集资金不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：1、2020 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2、2021 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

2022 年 08 月 26 日

附件 1:

2020 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位: 嘉兴斯达半导体股份有限公司

2022 年半年度

单位: 人民币元

募集资金总额				459,493,305.50		本年度投入募集资金总额				10,000,906.76		
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额				414,510,707.19		
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新能源汽车用 IGBT 模块扩产项目	不适用	159,493,305.50	不适用	159,493,305.50	27,821.57	160,549,830.47	1,056,524.97	100.66	2022 年 01 月	66,941,049.15	是	否
技术研发中心扩建项目	不适用	100,000,000.00	不适用	100,000,000.00	9,973,085.19	53,962,077.34	-46,037,922.66	53.96	2022 年 01 月		不适用	否
补充流动资金	不适用	200,000,000.00	不适用	200,000,000.00		199,998,799.38	-1,200.62	100.00	不适用		不适用	否
合计		459,493,305.50		459,493,305.50	10,000,906.76	414,510,707.19	-44,982,598.31					
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见专项报告三、(二)募投项目先期投入及置换情况							

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见专项报告三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见专项报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	详见专项报告三、（八）募集资金使用的其他情况

注：新能源汽车用 IGBT 模块扩产项目截至期末投入进度超 100.00%，系使用了募集资金用于现金管理取得的理财收益及利息收入资金。

附件 2:

2021 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位: 嘉兴斯达半导体股份有限公司

2022 年半年度

单位: 人民币元

募集资金总额				3,476,950,527.96		本年度投入募集资金总额				152,954,654.67		
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额				1,112,675,402.11		
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高压特色工艺功率芯片研发及产业化项目	不适用	1,476,950,527.96	不适用	1,476,950,527.96	33,274,331.59	115,922,547.58	-1,361,027,980.38	7.85	2024 年 11 月		不适用	否
SiC 芯片研发及产业化项目	不适用	500,000,000.00	不适用	500,000,000.00	32,714,921.19	49,470,673.46	-450,529,326.54	9.89	2024 年 11 月		不适用	否
功率半导体模块生产线自动化改造项目	不适用	700,000,000.00	不适用	700,000,000.00	86,965,401.89	147,282,181.07	-552,717,818.93	21.04	2024 年 11 月		不适用	否
补充流动资金	不适用	800,000,000.00	不适用	800,000,000.00		800,000,000.00		100.00	不适用		不适用	否
合计		3,476,950,527.96		3,476,950,527.96	152,954,654.67	1,112,675,402.11	-2,364,275,125.85					
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见专项报告三、（二）募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见专项报告三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见专项报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用